

关键指标

频率范围：DC~20GHz

插入损耗：0.25dB

衰减范围：0/0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5dB

输出输出驻波：1.2/1.2

芯片尺寸：0.74mm×0.65mm×0.1mm

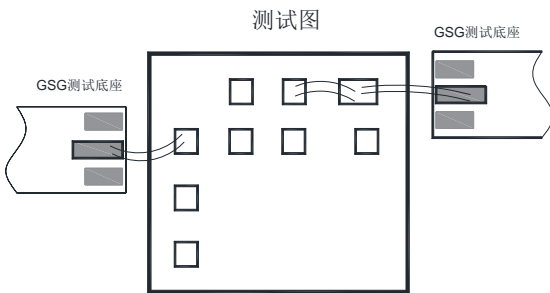
产品简介

HG136SA 是一款 DC~20GHz 固定衰减器芯片，输入输出驻波 1.2。

电性能 (TA=25℃, 键合测试)

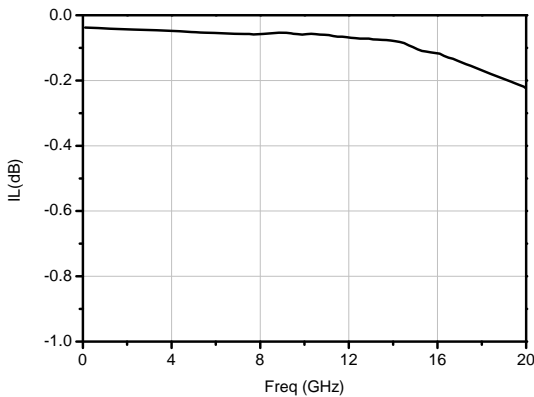
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~20		
插入损耗(dB)	-	0.25	-
衰减精度(dB)	-	±0.1	-
输入驻波	-	1.2	-
输出驻波	-	1.2	-

测试示意图 (芯片采用 GSG 测试座, 键合金丝测试)

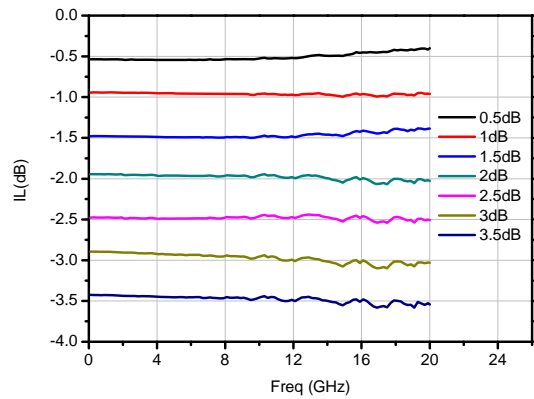


典型测试曲线

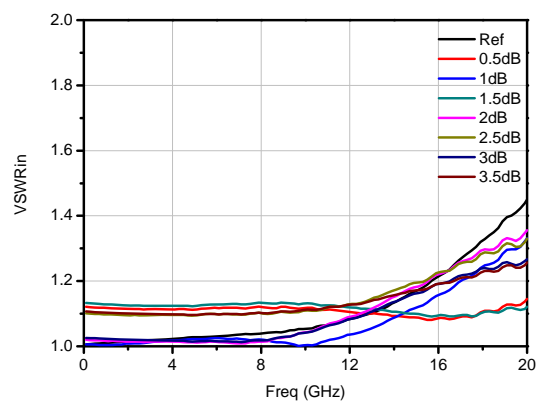
参考态插入损耗



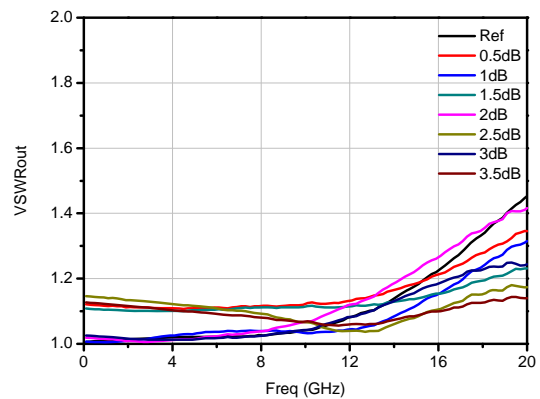
插入损耗



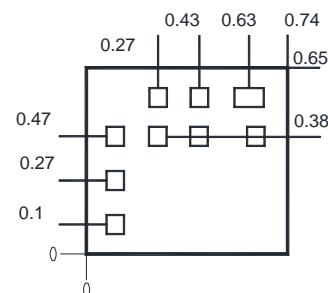
输入驻波



输出驻波

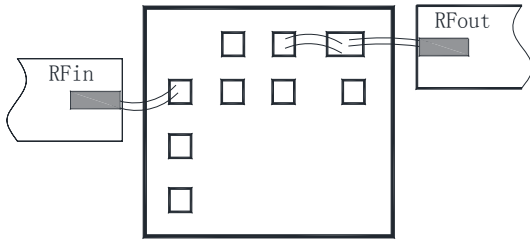


外形和端口尺寸 (mm)

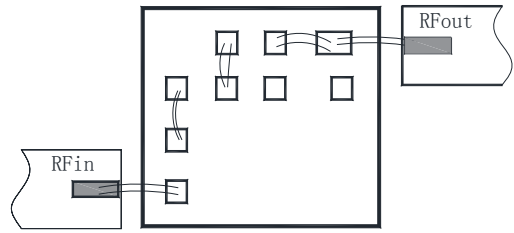


装配示意图

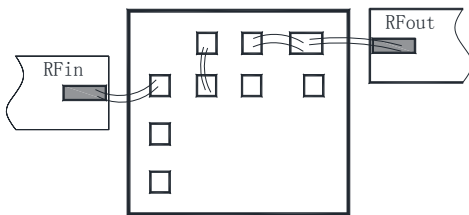
参考态键合



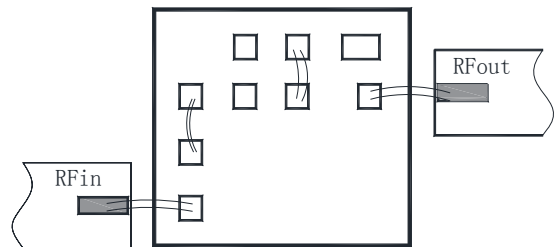
衰减2.5dB键合



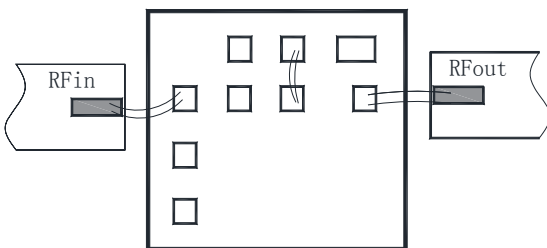
衰减0.5dB键合



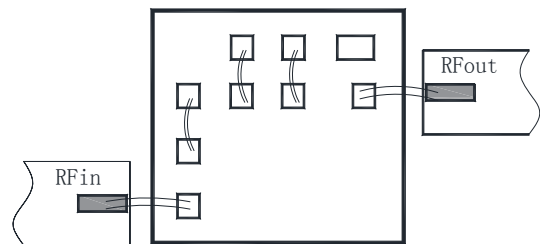
衰减3dB键合



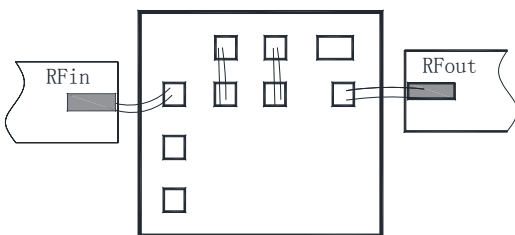
衰减1dB键合



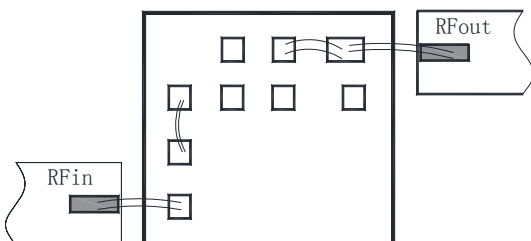
衰减3.5dB键合



衰减1.5dB键合



衰减2dB键合



绝对最大额定值

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55℃~125℃
贮存温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议芯片与基片键合金丝长度 250~400 μm ，芯片内部金丝键合长度 100~200 μm 。
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

V1.0(16/22)